

全球半導體產業

晶片設計及應用(上游)

IP設計 設計服務	ARM(安謀控股)、Synopsys(新思)、YMC(億而得) Faraday(智原)、GUC(創意電子)、芯原微 Alchip(世芯)
CPU/GPU	AMD(超微)、intel(英特爾)、威盛、NVIDIA
可程式化 晶片FPGA	Xilinx(賽靈思)、Altera
通訊多媒體 晶片/AP	海思半導體、聯發科技MTK、聯詠 RTK(瑞昱半導體)、Qualcomm(高通) Broadcom(博通)、Marvell(邁威爾) 思睿邏輯/凌雲邏輯
微控制器 MCU	Texas Instruments(德州儀器)、Renesas瑞薩 意法半導體、Microchip(微晶片)、Weltrend(偉詮) Nuvoton(新唐)、Hycon(紘康)、Holtek(盛群)
記憶體	Micron(美光)、Kioxia(鎧俠)、MXIC(旺宏) Winbond(華邦)、ESMT(品豪)、鈺創、愛普

晶圓製造(中游)

IDM 晶圓廠	Intel(英特爾)、NXP(恩智浦半導體) GlobalFoundries、infineon英飛凌、意法半導體 Micron(美光)、SK Hynix(海力士) Texas Instruments(德州儀器)、Winbond(華邦) Kioxia(鎧俠)、Samsung(三星)、南亞、MXIC(旺宏)
晶圓 代工廠	TSMC(台積電)、UMC(聯華)、Samsung(三星) PSMC(力晶積成)、SMIC(中芯)、華虹 VIS(世界先進積體電路)、穩懋半導體 SilTerra(馬來西亞矽佳晶圓)、AWSC(宏捷) Tower Jazz(高塔半導體)、VPEC(全新光電)
設備商	ASML(艾司摩爾)、Lam(科林研發) Applied Materials(應用材料)、ASM(先藝) TEL(東京威力科創)、KLA Corporation(科磊) Hitachi(日立)、Nikon(尼康)、Canon(佳能) Teradyne(泰瑞達)、SCREEN(迪恩士半導體) Advantest Corporation(愛德萬測試) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (亞太國際電機)
原材料廠	株式會社SUMCO(勝高)、Shin-Etsu(信越化學) Siltronic AG、LG、環球晶圓
光罩廠	DNP(大日本印刷株式會社) Toppan(凸版印刷株式會社)、Photronics 台灣光罩、HOYA(豪雅)

晶圓封裝測試(下游)

IC封裝 邏輯	日月光、矽品、Amkor(艾克爾)、江蘇長電、南通 富士通微、天水華天、KYEC(京元)、南茂 順邦超豐、華東、福懋科、TSMC(台積電)、精材
IC封裝 記憶體	力成、Winstek(台星科)、Transcend(矽格聯測) 華東、超豐、福懋科
周邊元件	MPI(旺矽)、FormFactor、MJC(美科樂) JEM(台灣傑睦)、Technoprobe(特諾本)
導線架	CWTC(長華)、界霖、SDI(順德)
基板	南亞、Ibiden、AT&S(奧特斯)、景碩欣興、日月光 矽品、TSMC(台積電)
模組	kingston(金士頓)、Transcend(矽格聯測) ADATA(威剛)